



機械設計（産業用装置）【接着・粘着素材の国内トップメーカー】

リンテック株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカトロ設計・...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

リンテック株式会社

Job ID

1481534

Industry

Chemical, Raw Materials

Job Type

Permanent Full-time

Location

Saitama Prefecture

Salary

4.5 million yen ~ 7 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】初年度10日6か月目から【休日】週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末年始 土曜、日曜、祝日、年末年始、夏...

Refreshed

June 20th, 2024 02:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2120258】

当社製品の産業用装置に関する機械設計（仕様検討～詳細設計）をご担当頂きます。
既存製品の仕様変更、新規開発案件があり、装置のシリーズ毎に担当者を付け、ご対応いただきます。

【製品例について】

・半導体材料のウェハに接着シートを貼付し、加工する装置（大きさ：2m×3m程度）

当社の接着素材を精密に塗布する加工技術が使われています。半導体メーカーのほとんどに当社製品が納入されており、粘着プロセスの半導体製造装置において国内メーカーとしてはトップシェアを誇ります。

・飲食品、通販パッケージ等にラベル・シールを高速で貼付する装置

粘着素材と機械装置の開発・製造・販売を一気通貫で対応しています。

【働き方】

- ・有給休暇取得率64%（半日単位でも使用可）
 - ・残業は平均20時間／月程度
 - ・育休復帰率100%（2017年度利用者36名）
- 結婚、出産などのライフイベントの後も仕事を続ける社員がほとんどです。

Required Skills

【必須】 ・3D CADでの機械設計経験 【尚可】 ・装置設計経験

Company Description

粘着素材、特殊紙、加工紙・加工フィルム、光学機能性フィルム、半導体関連製品、包装機・印刷機等の研究開発・製造・販売